УДК 621.391.01: 621.315.592



Коржуєв М.О.

Інститут металургії й матеріалознавства ім. А.А. Байкова РАН, Ленінський просп., 49, Москва, 119991, Росія

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ НАНОСТРУКТУРИ. ЗА І ПРОТИ

Коржуєв М.О.

Визначено межі росту параметрів добротності Z і потужності W термоелектричних матеріалів (TEM) за нано - структурування. Показано, що параметри Z і W наноструктур (HC) змінюються за рахунок переходів $\lambda_{ph} \rightarrow a \, i \, \lambda_e \rightarrow a \, y \, TEM$ (тут a - міжатомна відстань, λph і λ_e - середня довжина вільного пробігу фононів і електронів у зразках). Виявлено, що в інтервалі $l \sim \lambda_{ph}/a < \lambda_e/a < 2$ - 3 перехід $\lambda_e \rightarrow a$ може бути використаний для одночасного збільшення Z і W ТЕМ. Встановлено, що НС ТЕМ з параметрами Z і W, збільшеними одночасно, можуть ефективно працювати в режимі максимальної потужності в силових термоелектричних перетворювачах енергії. Виявлено також деякі негативні характеристики HC TEM. Це - неузгодженість параметрів Z і W TEM щодо оптимальної концентрації носіїв струму, підвищення електричних і теплових опорів контактів, а також розвиток дифузійної нестійкості зразків за високих температур $T > T_T \sim 0.5 \ Tm \sim$ 400- 500 К. (Тут Т_Т і Т_т - температури Таммана й плавлення матеріалів).

Ключові слова: термоелектрика, добротність Z і потужність W, нано- структури (HC).

Limits of increase in parameters figure of merit Z and power W of thermoelectric materials (TEM) are defined at their nano - structurization. It is shown that parameters Z and W nanostructures change at the expense of transitions $\lambda_{ph} \rightarrow a$ and $\lambda_e \rightarrow a$ in T3M. (Here a is an interatomic distance, λ_{ph} and λ_e are the mean free path of phonons and electrons in samples). In addition, it is revealed that in interval $1 \sim \lambda_{ph}/a < \lambda_e/a < 2$ - 3 transition $\lambda_e \rightarrow a$ can be used for simultaneous increase Z and W TEM. Furthermore, it is established that nano - structures TEM with parameters Z and W, increased simultaneously, can effectively work in a mode of the maximum capacity in power thermoelectric converters of energy. On the other hand, some negative characteristics nano structures revealed also. Them are - a mismatch of parameters Z and W TEM on optimum carrier concentration, increase of electric and thermal contact resistance, and also development diffusive instability nano - structures at high temperatures $T_T \sim 0.5 T_m \sim 400$ - 500 K. (Here T_T and T_m are the temperatures of Tammann and melting of materials).

Key words: thermoelectricity, figure of merit Z and power W, nano – structures (NS).

Вступ

Нині багато дослідників вивчають властивості нано - розмірних часток речовини ($x \sim 10^{-9}$ м), а також утворених на їхній основі об'ємних гетерогенних наноструктур (HC) з малим періодом ідентичності x=1-100 нм [1]. Знайдено, що властивості таких HC можуть суттєво відрізнятися від властивостей однорідних кристалічних матеріалів, що пов'язується, звичайно, з дією поверхневих і (або) квантово- розмірних ефектів [2]. Так, для ряду HC термоелектричних

матеріалів (ТЕМ) спостерігали істотний ріст параметрів термоелектричної добротності Z = W/к (до 5 разів і більше) і потужності $W = \alpha^2 \sigma$ (до ~1.5-2 разів) за кімнатної температури (табл.1). (Тут α – коефіцієнт Зеєбека, σ і $\kappa = \kappa_L + \kappa_e$ – питомі електропровідність і теплопровідність, κ_L і κ_e – граткова й електронна складові теплопровідності) [3-4]. Як відомо, максимальні значення добротності ТЕМ досягаються за температур $T_{max} = E_g/bk_0$, які визначаються початком розвитку власної провідності в зразках.

$$Z_{\max} \sim W_{\max} \kappa_p^{-1} \sim N_{m_d}^{3/2} \mu T^{3/2} e^{\gamma} \kappa_p^{-1};$$
(1)

(Тут N – число еквівалентних экстремумів у зоні провідності (валентної), m_d – ефективна маса густини станів в окремому екстремумі, $\mu = \sigma/(en(p)) - рухливість, e - елементарний заряд, <math>n(p) - \rho$ концентрація електронів (дірок) у зразках, T – абсолютна температура, r – параметр розсіювання, Eg – ширина забороненої зони, k0 – постійна Больцмана, b= 5- 10 – коефіцієнт, який змінюється залежно від співвідношення рухливостей електронів і дірок $a = \mu_e/\mu_p$ у зразках) [3- 4]. Звичайно, вважають, що з переходом «кристал → HC» зонна структура ТЕМ не змінюється (N, $m_d \sim \text{const}$) [1]. При цьому ріст Z_{max} НС ТЕМ пояснюється зменшенням κ_L і ростом r, пов'язаними з додатковим розсіюванням фононів і електронів (дірок) на неоднорідностях з x = 1- 100 нм (табл.1) [1, 2]. Дослідження НС ТЕМ є новим, перспективним напрямком сучасного матеріалознавства. При цьому поряд з очевидними перевагами НС ТЕМ виявлені також і деякі їхні істотні недоліки. Так, ріст Z зразків, як правило, супроводжується зниженням σ і W, що утрудняє використання НС ТЕМ у силових термоелектричних перетворювачах (ТЕП) (генераторах (ТЕГ), охолоджувачах (ТЕО), нагрівачах (ТЕН)), що працюють у режимі максимальної потужності [1]. Крім того, для НС ТЕМ характерні також складність одержання й дорожнеча, токсичність і знижена відтворюваність характеристик [5]. Істотний недолік НС – їхня нестійкість (морфологічна, дифузійна, хімічна), що проявляється в процесі виготовлення, зберігання й експлуатації зразків [1,2]. Нарешті, з установкою НС у ТЕП виникають додаткові проблеми, пов'язані з оптимізацією матеріалів і комутацією віток [1-6]. Метою пропонованої роботи був всебічний аналіз переваг і недоліків НС ТЕМ, а також визначення найближчих перспектив їх використання в ТЕП.

1. Одержання й властивості НС ТЕМ

1.1. Утворення фази «фононне скло – електронний кристал»

Об'ємні НС ТЕМ одержували різними методами, які умовно можна підрозділити на «штучні» і «природні» (табл.1) [5- 14]. У першому випадку необхідні періоди ідентичності x у зразках задавали за допомогою додаткових технологічних операцій (здрібнювання з наступним спіканням, напилювання й епітаксіальне нарощування нано - шарів, введення «квантових точок», опромінення й ін.) (табл.1) [5, 7-9]. У другому випадку (більш дешевому й перспективному) нано - подібні структури ТЕМ виходили «спонтанно», у результаті «самоорганізації» однорідних, нерівноважних зразків, за різних фазових переходів (розпад пересичених твердих розчинів, надструктурні переходи, легування й самолегування неупорядкованих фаз і ін.) (табл.1) [6, 10- 14]. У всіх випадках найближчою метою дослідників було одержання на основі ТЕМ фази «фононне скло - електронний кристал» (ФСЕК) (табл.1) [2]. ФСЕК є частково розупорядкованою фазою ТЕМ, яка характеризується низькою теплопровідністю κ_L , властивою аморфним матеріалам, і високою електропровідністю σ , властивою кристалам [1, 2]. У результаті з переходом «кристал $\rightarrow \Phi$ СЕК» може спостерігатися значний ріст параметра Z ТЕМ [1].

		1			метод	ами				·7F7		I ···
«Природний»	Кристаліза- ція надграток [14]	$GeBi_4Te_7$	2.4	300	$14^{**} \sim 1.4^{**}$	-160	500	0.8	12.8**	1.6^{**}	-	ідстань між
	Перехід в суперіон ну фазу (7>413 К) [11-13]	Cu _{1.99} Se	${\sim}0.6^{\circ}$	700	0.9** 1**	240	190	1.0	11	1.1	Скло	и; ^d – середня в
	Легування параелектричної фази (T ₀ >630-700K) [6] ⁸	TAGS- 90 [°]	$\sim 0.9^{d}$	800→75	$3 \rightarrow 2^{**}$ $3 \rightarrow 1^{**}$	140→20	2000→1	45→~2	39→40	0.9→1.7	+	іми домішкі
		GeTe < 5% B i	$\sim 1.2^{d}$	800→750	3→2** 3→1.1**	140→200	2000→100	45→~1.8	39→27	0.9→1.7	+	гань між атома
	Спінодальний розпад, наночастинки <i>PbS</i> (3-5 нм) [10] ⁸	$(PbTe)_{0.92}(PbS)_{0/08}$	10-20	650	10→7.5** 4.0→1.8**	-200→(-200) ^{**}	400→(300) ^{**}	1.1→0.5**	16→12	1.4→2.3		<i>GeTe</i> ; ^с - середня відст
«Штучний»	Надшвидке охолоджен- ня і пресування [9]	$Bi_{0,52}Sb_{1,48}Te_{3}$	$10^4/10^{3*}$	300	9.2→6.0 ^{**} 2.5→1.7 ^{**}	230→250	850→550	1.36→0.9	45→34	~3.3→3.7	ı	^ь – порівняння з
	Подрібне- ння в млині і пресуванніі [5]	$Bi_{0,3}Sb_{1,7}Te_3$	10/(100-300)	300	8.8→6.2** 1.5→1.7**	196→213	810→580	0.94→0.82	318.8→26	~3.1→3.2	-	а цієї роботи. ^а – порівняння з <i>PbTe;</i> ратками
	Напилення надграток [8]	Bi_2Te_3/Sb_2Te	16	300	8.8→6.4** 3.3→1.03**	250→261 ^{**}	810→510	1.45→0.6	51→40	~3.5→6.7	+	
	Введення квантових точок [7]	PbTe/PbSeTe	10	300	9.2→8.6 ^{**} 6.0→1.2 ^{**}	-300→330**	300→290**	2.5→0.6	28→32	~1.1→6.7	+	сування; ** оцінк: зллавленими підг
	Метод отримання НС	Зразок	мн Х	T, K	$\overline{\lambda_e} / a \ \lambda_{_{ph}} / a$	а, мкВ/К	σ, CM/cM	к, Вт/(м К)	W, BT/(cM K)	Z 10 ³ , 1/K	Фаза ФСЕК	*– до/ після пре атомами міді ро

Зміна властивостей зразків і «природньому» нано- структурування ТЕМ різними

Коржуєв М.А. Термоелектричні наноструктури. За і проти Можливість утворення фази ФСЕК у ТЕМ пов'язана з відмінністю середніх довжинах вільного пробігу фононів і електронів у кристалах:

$$\lambda_{\rm ph} = 3 \kappa_{\rm ph} / C V \tag{2}$$

$$l_{\rm e} = vt = \left(2E_{\rm F} / m_{\rm d}\right)^{1/2} m_{\rm e} m / e = \hbar (3\pi^2 n / N^2)^{1/3} \mu / e.$$
(3)

Тут $C = C_{mol} d/M$ – теплоємність одиниці об'єму, C_{mol} – молярна теплоємність, d – густина, Mмолекулярна маса, V – швидкість звуку, v і $\tau = \tau_0 E^{r-\frac{1}{2}}$ – швидкість, і середній по енергії E час релаксації електронів або дірок, r – параметр розсіювання, τ_0 – незалежний від енергії множник, E_F – енергія Фермі, e – елементарний заряд, μ - рухливість носіїв струму, $N = m_d/m_c$ – число екстремумів у зоні, m_c і m_d – ефективні маси провідності й густини станів електронів (дірок) у зразках [15, 16]. Звичайно, для кристалічних напівпровідників маємо: $a \ll \lambda_{ph} \ll \lambda_e$ (тут $a \sim$ 0.3 нм – міжатомна відстань) (3, рис.1) [16]. Однак кристалічні ТЕМ відбиралися серед напівпровідникових матеріалів за критерієм Z_{max} (1). Тому вони відрізняються низькими значеннями κ_p і більшими N, що згідно з (1) і (2) визначає низькі значення λ_{ph} і λ_e у зразках (рис.1) [15- 19]. Таким чином, ТЕМ виявляється ближче до переходів $\lambda_{ph} \rightarrow a$ і $\lambda_e \rightarrow a$, чим звичайні напівпровідникові матеріали, що полегшує утворення фази ФСЕК у зразках [16]. Оскільки перехід $\lambda_{ph} \rightarrow a$ у ТЕМ, звичайно, завершується швидше, ніж перехід $\lambda_e \rightarrow a$, в інтервалі

$$a = l_{\rm ph} < l_{\rm e} \tag{4}$$

виявляється можливим утворення фази ФСЕК (5, 6, рис.1) [16].



Рис. 1.Залежність довжини вільного пробігу фононів λ_{ph}/a (1) и електронів λ_e/a (2) від фактору розсіювання (3-7). Зразки: 3 – тверді напівпровідники; 4-7 – ТЕМ; 5-6- фаза ФСЕК; 7 – аморфні тіла.
Матеріали: 4- PbTe [1, 6]; 5- PbTe/ PbSeTe (1~ λ_{ph}/a < λ_e/a) [7]; 6 –TAGS (1~ λ_{ph}/a < λ_e/a < 2-3) [6, 10]; 7 - Cu_{1.99}Se (1~ λ_{ph}/a ~ λ_e/a) [11-13].
Температура, Т, К: 5 – 300; 4 – 600; 6, 7 – 700.

1.2. Л- діагностика НС ТЕМ

Для визначення приналежності зразків (табл.1) до фази ФСЕК (3) використаний метод λ діагностики ТЕМ, заснований на оцінці величин λ_{ph} і λ_e за формулами (1) і (2) [16]. Під час

оцінок використовувалися дані оригінальних робіт, а також довідкові дані [20-21]. Для сплавів GeTe < Bi > i TAGS-90 параметри x розраховувалися в наближенні рівномірного розподілу по зразку легуючих добавок, а для сплавів $Cu_{1.99}Se - рухливої міжвузлової міді (<math>T > Tc = 700 \text{ K}$) (табл.1). З табл.1 видно, що для зразків PbTe/PbSeTe [7] і Bi₂Te₃/Sb₂Te₃ [8] фаза ФСЕК (3) утворюється вже за кімнатної температури, що підтверджується різким збільшенням Z в ~ 2- 5 разів. ¹Утворення фази ФСЕК (3) відзначено також у легованих сплавах GeTe < Bi > i TAGS-90 [6] за температури Т= 750- 800 К, що супроводжувалося збільшенням Z в ~ 2 раза порівняно з GeTe (табл.1). Близькими до утворення фази ФСЕК були також зразки (PbTe)0.92(PbS)0.08 [10] (ріст Z^{650K} в ~ 1.6 раз у порівнянні з *PbTe*) і *GeBi*₄*Te*₇ [14] (ріст $Z^{300 \text{ K}}$ в ~ 1.6 раза у порівняно з GeTe) (табл.1). Однак, у зразках $Bi_{0.3}Sb_{1.7}Te_3$ [5] і $Bi_{0.52}Sb_{1.48}Te_3$ [9] перехід $\lambda_{ph} \rightarrow a$ виявився незавершеним, фазу ФСЕК одержати не вдалося, у результаті величина Z зросла незначно (табл.1). Незавершеність переходу $\lambda ph \rightarrow$ а у зразку $Bi_{0.52}Sb_{1.48}Te_3$ [9] (табл.1) пов'язана з недостатнім диспергуванням матеріалу ($x \sim 103$ нм). У той же час зразок $Bi_{0.3}Sb_{1.7}Te_3$ [5] (табл.1), отриманий з нано - часток необхідних розмірів ($x \sim 10$ нм), у процесі гарячого пресування зазнавав рекристалізації зі збільшенням зерна (ефект «виштовхування» з нано - області) (x= 10 → 300 нм) [16]. Крім того, у всіх НС ТЕМ (табл.1) спостерігався також перехід $\lambda e \rightarrow a$, пов'язаний зі збільшенням розсіювання електронів (дірок) за диспергування зразків. У суперіонному $Cu_{1.99}Se$ обидва переходи $\lambda_{ph} \rightarrow a$ і $\lambda_e \rightarrow a$ повністю завершувалися (T=700 K), при цьому зразок ставав квазі - аморфним ($\lambda_e \sim \lambda_{ph} \sim a$) (7, рис.1) [11-13]. Дані λ - діагностики НС ТЕМ (табл.1) дають можливість визначити основні механізми, відповідальні за зміну Z і W. З табл.1 видно, що утворення фази ФСЕК і ріст Z НС ТЕМ відбувається за рахунок зменшення $\kappa_{L\sim} \lambda_{ph}$ з переходом $\lambda_{ph} \rightarrow$ а. При цьому супутній перехід $\lambda e \rightarrow$ а здебільшого знижує W ТЕМ через зменшення $\sigma \sim \lambda_e$ (табл.1). Виняток становлять зразки *PbTe/ PbSeTe* [7] i TAGS-90 [6] (табл.1), для яких спостерігався незначний ріст *W*, пов'язаний зі збільшенням *a* зразків. У випадку HC [7] ріст α пояснювався додатковим розсіюванням носіїв струму на «квантових точках» (x= 10- 16 нм) [1], а для зразка [6] - особливостями зонної структури ТЕМ у перехідній області $1 < \lambda_e / a \sim 3$ [16].

1.3. Двоканальна зонна модель ТЕМ

Згідно з [15, 16], зонна структура ТЕМ у перехідній області $1 < \lambda_e/a \sim 2$ - 3 суттєво змінюється. З переходом $\lambda_e \rightarrow a$ в ТЕМ у доповнення до «зонного» каналу провідності ($\lambda_e/a > 1$) (1, рис.2) у зоні провідності (валентній) утворюється дифузійний канал провідності (2), пов'язаний з появою групи носіїв струму з низькою рухливістю, що переміщаються по вузлах кристалічних граток ($\lambda_e/a = 1$) [15]. З подальшим збільшенням розсіювання «зонні» носії струму зникають, а «дифузійні» захоплюють усю зону (стрілка, рис.2). Модель (рис.2) відповідає зразкам *p*-типу провідності й акустичному механізму розсіювання (*r*=0). Зі збільшенням *r* > ½ ситуація змінюється – «дифузійний» канал провідності (2, рис.2) утворюється поблизу краю зони, а потім поширюється по зоні в область більших енергій [16].

У двоканальній моделі (рис.2) кінетичні коефіцієнти зразків з постійною загальною концентрацією носіїв струму ($p = p_1 + p_2 = \text{const}$) подаються виразами $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$, і $\alpha = \alpha_1 \cdot t_1 + \alpha_2 \cdot t_2$ (тут $t_i = \sigma_i / \sigma$ - числа переносу, α_i і σ_i – парціальні термоЕРС і питомі електропровідності, i= 1, 2

¹ Згідно з [5], результати робіт [7,8] до теперішнього часу не вдалося відтворити ні в одній іншій лабораторії світу, прилади на основі отриманих НС також не створені.

– номери каналів з «зонною» ($\lambda_e > a$) і «дифузійною» ($\lambda_e = a$) провідністю відповідно) [16]. На рис.З наведено результати розрахунків відносної зміни термоелектричної добротності Z (крива 1), потужності W (крива 2) й теплопровідності κ (крива 3) зразків ТЕМ в області існування фази ФСЕК. У розрахунках використовувались зонні параметри $\mu_1/\mu_2 \sim \kappa_L/\kappa_e \sim 10$ і $\kappa_L^{\text{крист}}/\kappa_L^{\text{ФСЕК}}=3$ (тут $\mu_{1,2}$ – парціальні рухливості, κ_L і κ_e – граткова й електронна складові теплопровідності), а також параметри розсіювання r=0 (акустичне розсіювання) і $r = \frac{1}{2}$ (розсіювання на нейтральних центрах) для «зонного» (1) й «дифузійного» (2) каналів провідності відповідно (рис.2) [16].



Рис. 2. - Двоканальна зонна модель ТЕМ. Зони: v – валентна; c – провідності. Канали: 1 – «зонний» (λ_e > a), 2 – «дифузійний» (λ_e = a). Стрілкою показано напрямок зсуву границі каналів по шкалі енергій з ростом розсіювання в зразках (p- тип провідності, r= 0) [15,16].



Z(1), потужності W(2) й теплопровідності $\kappa(3)$ з переходами $\lambda_{ph} \rightarrow a$ (4, 5) і $\lambda_e \rightarrow a$ (6) в ТЕМ в залежності від числа переносу зонних носіїв струму t_1 (T=const).

3 рис.3 випливає, що в інтервалі $1 < \lambda_e/a < 2$ - 3 величини Z і W TEM можуть зростати одночасно (криві 1 і 2). За $t_1 \sim 0.8$ можливе максимальне підвищення Z в ~ 2.5- 3 рази й W- в 1.3-1. 4 раза (криві 1 і 2 рис.3) за рахунок спільної дії переходів $\lambda_{ph} \rightarrow$ а і $\lambda_e \rightarrow a$. Можливість росту α і W (3, рис.3) у моделі (рис.2) пов'язана із селекцією по енергії «зонних» і «дифузійних» носіїв струму, що брали участь у провідності [16]. Раніше модель (рис.2) використовувалася для пояснення аномального росту Z і W сплавів GeTe і Cu_{1.99}Se за високої температури [15]. Згідно з оцінками (рис.3), двоканальна провідність може бути відповідальна також за одночасний ріст Z і W за високої температури (T= 700- 800 K) у нано - подібних структурах типу p-TAGS ((AgSbTe₂)_{1-x}(GeTe)_x) ($\lambda_e/a \sim 2$) (табл.1) [6, 10], а також n, p- LAST- m (AgPbmSbTe_{2+m}, m= 18-22) (ZT= 1.6- 2.2) [10].

2. Порівняння НС ТЕМ і кристалічних ТЕМ

2.1. Л- діагностика кристалічних ТЕМ

Результати Л- діагностики кристалічних ТЕМ наведено на рис. 4 (а - е). На рис. 4а й 4б показано політерми λ_{ph} / a (a), $\lambda_{e'}$ a (б) ($T = T_{max}$) (криві 3 і 4) залежно від E_g кращих низько-, середньо- і високотемпературних ТЕМ [1,6,10,11-13, 21, 22]. На рис. 4в й 4г наведено відповідні політерми T_{max} (криві 5- 8), а також оптимальної концентрація носіїв струму $n^{onm}(p^{onm})$ (крива 9) і енергія Фермі *EF* ТЕМ (крива 11). З рис.4а й 4б видно, що з ростом E_g і T_{max} у кристалічних ТЕМ відбуваються переходи $\lambda_{ph} \rightarrow a$ і $\lambda_e \rightarrow a$, що змінюють характеристики зразків. На рис.4в показано, як впливає перехід $\lambda_e \rightarrow a$ на величину T_{max} TEM (криві 7 і 8). Згідно з рис.4в, віддалені від переходу $\lambda_e \rightarrow a$ ($\lambda_e/a > 10$, $E_g < 0.4$ eB) ТЕМ поводяться як звичайні напівпровідники з високою рухливістю µ, при цьому значення T_{max} перебувають в інтервалі 5 < b <10 (5-8, рис. 4в). Однак за $E_g > 0.5$ - 0.7 эВ і $\lambda_e/a < 2$ -3 значення T_{max} виходять за межі інтервалу 5 < b <10 (криві 7 і 8, рис. 4в). Ефект пояснюється появою в зразках «дифузійних» носіїв струму з низькою рухливістю ($\lambda_e = a$), що збільшує відносний внесок неосновних носіїв струму в розвиток власної провідності в зразках (r=0) [15, 16]. При цьому маємо $T_{max}(p) < T_{max}(n)$ (криві 7 і 8, рис. 4в), оскільки звичайно $a = \mu_e/\mu_D > 1$ [11]. Перехід $\lambda_e \rightarrow a$ впливає також на політерми $n^{onm}(p)^{onm}$, $E_F = f(E_g)$ TEM (рис. 4г), де спостерігається зниження швидкості росту $n^{\text{опт}}(p)^{\text{опт}}$ (крива 9) і навіть невелике зменшення $E_F \sim \frac{1}{2} k_0 T_{max}$ (крива 11), зв'язане зі зниженням T_{max} в області λ_e ~ a (крива 10). На рис. 4д і 4е показано політерми добротності (*ZT*)_{тах} (крива 12) і потужності $W = f(E_g)$ (крива 15) кристалічних ТЭМ ($T = T_{max}$). Крива 12 (рис. 4д) має протяжний максимум (ZT)_{max} ~ 1 в інтервалі 0.1 eB < E_g < 1.0 eB і спади в області малих і більших E_g . Згідно з рис. 4а й 4е, умова (ZT)_{max} ~ 1 в інтервалі 0.1 eB < E_g < 0.6 eB (крива 12, рис.4д) підтримується за рахунок дії, що компенсує, переходів $\lambda_{ph} \rightarrow a \ i \ \lambda \rightarrow a$, що призводять до одночасного зниження *L i W* зразків.

При цьому спад на кривій 12, рис.4д за $E_g > 1.0$ eB пов'язаний із завершенням переходу $\lambda e \rightarrow a$ ($\lambda e/a=1$), а спад за Eg < 0.1 eB – з вимогами термодинаміки - α , $W \rightarrow 0$, за $T \rightarrow 0$, [1, 4, 6]. Отримані результати (рис.4) показують, що механізми підвищення Z i W у HC i в кристалічних TEM за високої температури мають ту саму фізичну природу. При цьому відмінність характеристик HC TEM і кристалічних TEM за T= const пов'язана з різними стадіями переходів $\lambda_{ph} \rightarrow a$ і $\lambda_e \rightarrow$ а у зразках. Звідси випливає, що очікувані характеристики HC TEM можуть бути оцінені, виходячи із властивостей кристалічних TEM з переходом «кристал $\rightarrow \Phi$ CEK» показано стрілками на рис. 4.



Рис. 4. Політерми λ_{ph}/a (a), λ_e/a (b), T_{max} (b), n^{onm} (p^{onm}) и E_F (г) (ZT)_{max} (d) і W (T_{max}) (e) в залежності від ширини забороненої зони E_g TEM (T= T_{max}). Зразки: 1-12 – кристали [1, 6, 10, 11-13, 20-22]; 13-14 – HC [7, 8, 10, 22].

Матеріали (в порядку зростання E_g): 1 - n- тип (BiSb, Bi₂Te₃, PbTe, CoSb₃, SiGe);

2-p-mun (BiSb<Sn>, Sb₂Te₃, PbTe, TAGS, GeTe, SiGe, Cu_{1.99}Se).

1, 2, 14- експеримент; 5, 6, 10, 13 – розрахунок. Розрахункові формули:

5, 6 - $E_g = bk_0T$ (b: 5 - 5; 6 - 10); 10 - $E = k_0T_{max}$; 13 - $y = (ZT_{max} (\kappa puba \ 12)) * (\lambda_{ph}/a)$.

Напрями можливих змін характеристик ТЕМ з утворенням НС показано стрілками.

2.2. Перехід «кристал → ФСЕК»

Згідно з рис. 4 за умови E_g = const перехід «кристал $\rightarrow \Phi$ СЕК» у ТЕМ призводить до зменшення λ_{ph} і λ_e , T_{max} , $n^{\text{опт}}$ ($p^{\text{опт}}$), E_F , а також W (за $E_g < 0.4 \text{ eB}$). При цьому для будь-яких значень Eg величина ZT збільшується за рахунок зменшення κ_L НС (криві 12 \rightarrow 13, рис.4д). Крива 13, рис.4д дає верхню межу збільшення ZT зразків з переходом у фазу ФСЕК. Крива 13, рис.4д була розрахована для НС за формулою (1), виходячи із кривої 12 для кристалів за умови $\lambda_{ph}/a = 1$ (рис. 4д). 3 рис.4д видно, що найбільше збільшення ZT з переходом у фазу ФСЕК (до ~10) можна чекати тільки за $T_{max} < 600$ K і $E_g < 0.4$ еВ (крива 12 \rightarrow 13). За $T_{max} > 600$ K і $E_g > 0.4$ еВ можливості збільшення ZT НС у фазі ФСЕК суттєво знижуються (до ~ 1.5) (рис. 4д).² Експериментальні дані (ZT)_{max} НС ТЕМ (14, рис. 4д) у цілому підтверджують отриманий висновок. Додатковим фактором росту (ZT)_{max} НС ТЕМ може бути також ріст параметра потужності W з переходом $\lambda_e/a \rightarrow 1$, пов'язаний зі зрушенням особливості W в інтервалі $1 < \lambda_e/a < 3$ в область малих E_g (рис. 4е).

2.3. Одночасне збільшення Z і W ТЕМ

Основною проблемою використання НС ТЕМ у ТЕП є зниження в більшості випадків параметра потужності W HC порівняно із кристалічними матеріалами (табл.1) [1,2]. Як відомо, величина Z ТЕМ визначає максимальний перепад температур ТЕО й ТЕН - $\Delta T_{max} = \frac{1}{2} Z T_{12} = \frac{1}{2}$ $Z((1+2T_0Z)^{\frac{1}{2}} - 1)/Z)^2$ і ККД ТЕП - $\eta = \eta_3 (M_{0-1})/(M_0 + Tc / Th)$ (режим максимального ККД), або $\eta = \eta_c / (2 + 4/ZTh - \eta_c/2)$ (режим максимальної потужності) (тут $\eta_c = (T_0 + T_1) / T_1 - \phi_a$ ктор Карно, M = R/r- відносне електричне навантаження ТЕГ; R – електричний опір навантаження; $M_0 = (1 + 1)$ $Z \overline{T}$)^{1/2}; \overline{T} = ¹/₂ ($T_0 + T_1$) – середня температура) [1]. З іншого боку, W ТЕМ визначає максимальну холодопродуктивність ТЕО й ТЕН – $Q_{max} = \Delta T_{max} \kappa S/l \sim \frac{1}{2} W T_{12}$, а також максимальну корисну потужність ТЕГ $W_{max} = W \Delta T^{2/4} = WS/4l$ [1, 6]. Як приклад на рис.5 наведена відносна зміна перепаду температур ΔT / ΔT_0 TEO з різними Z і W залежно від холодопродуктивності Q/ Q₀. З рис.5 видно, що з використанням НС ТЕМ з підвищеними Z (криві 2-4) у режимі нульового теплового навантаження (Q = 0) завжди можна чекати росту ΔT_{max} у порівнянні із кристалами (крива 1). Однак з переходом до режиму максимальної потужності з ростом Q на рис.5 з'являється область (5), де характеристики НС поступаються перед кристалами. Звідси випливає, що для повноцінного використання НС ТЕМ у ТЕП необхідне одночасне збільшення параметрів Z і W (1 \rightarrow 3, 4, рис.5) [1, 10, 20]. Для одночасного росту Z i W ТЕМ найбільшу ефективність показала оптимізація зонних параметрів матеріалів (N, E_F і ширини забороненої зони E_g). Також можливе використання квантово – розмірних ефектів (надгратки, квантові ями, дроти й точки й ін.), створення в дозволеній зоні поблизу Е_F «резонансних» станів, використання розсіювання на границях зерен, що забезпечує «фільтрацію» носіїв струму по енергіях (ріст r i a) [1, 4, 6, 8, 10]. Згідно з рис. 3 – 4 для одночасного збільшення Z i W HC TEM можна використовувати також ефект «двохканальної» провідності, що діє в ТЕМ в інтервалі $1 \sim \lambda_{ph}/a < \lambda_{e}/a < 2 - 3$. За необхідністю подальше збільшення Z i W TEM можливе за рахунок використання квантових ефектів у HC [1, 10, 20].

² Цей висновок стосується до усереднених значень Z ТЕМ. Наприклад, у сплавах *SiGe*, де $\lambda_{ph} / a \sim 8$ (рис. 4a), існують значні додаткові резерви зростання Z [1].



Рис. 5. Відносна зміна перепаду температур $\Delta T / \Delta T_0 (1-4)$ в залежності від холодопродуктивності Q/Q_0 ТЕО. Матеріали: 1 – кристали ($\Delta T / \Delta T_0 = Q / Q_0 = 1$); 2-4 - HC. $Z_{HC} / Z_{KP} = 3$; W_{HC} / W_{KP} : 2-0.7; 3-1; 4-1.3. 5область, де характеристики HC (2) поступаються кристалам (1).

3. Інші проблеми використання НС ТЕМ

3.1. Нестійкість НС ТЕМ

Різні види нестійкості НС ТЕМ безпосередньо пов'язані з нестійкістю утворюючих їх нано – часток, які мають підвищену поверхневу енергію [1, 2, 23]. Тому в процесі компактування таких нано – часток з одержанням об'ємних матеріалів спостерігається рекристалізація зерен, що супроводжується ростом їх розмірів на кілька порядків («ефект виштовхування» з нано – області) (табл.1) [5]. У деяких випадках ефект «виштовхування» вдається побороти, наприклад, шляхом використання методу плазмового спікання часток, що супроводжується утворенням вторинної субструктури зерен [1, 10, 22]. Однак основним видом нестійкості НС ТЕМ є їхня дифузійна нестійкість, що проявляється за підвищення температури $T > T_T \sim 0.4$ - 0.6 $T_m \sim 400$ - 700 K (Тут T_T i T_m – температури Таммана й плавлення матеріалів відповідно) [22]. На рис. 6 наведено температури плавлення T_m (1), T_{max} (2) і Таммана $T_T = 0.6 T_m$ (3) кристалічних ТЕМ залежно від E_g зразків.



Рис. 6. Температури плавлення $T_m(1)$, $T_{max}(2)$ і Таммана $T_T = 0.6 T_m(3)$ кристалічних ТЕМ в залежності від ширини забороненої зони E_g . 4 і 5 – інтервали стійкості і нестійкості HC за $T = T_{max}$. Зразки: див. підпис до рис.4.

3 рис. 6 видно, що за $T_{max} > 500$ - 600 K і $E_g > 0.3$ еВ НС ТЕМ виявляються нестійкими за температури $T \sim T_{max}$ (інтервал 5). Стійкими за температури T_{max} залишаються тільки сплави з $T_{max} < 500$ K і $E_g < 0.3$ (інтервал 4), що суттєво обмежує перспективи використання НС в області високих температур. Цей висновок повною мірою стосується до «штучних» НС ТЕМ і меншою мірою – НС

ТЕМ, отриманих з розпадом пересичених твердих розчинів (табл.1). Ще менше цей висновок стосується природних надграток ТЕМ, отриманих кристалізацією з розплаву [1], а також сильно розупорядкованих нано - подібних структур типу $Ge_{1-x}Te$, TAGS, LAST і $Cu_{2-x}Se$ (табл.1). З дифузійною нестійкістю НС ТЕМ безпосередньо зв'язана також їх хімічна нестійкість, обумовлена високою швидкістю дифузії реагентів по границях зерен. Для боротьби з хімічною нестійкістю НС ТЕМ успішно використовуються різні технічні методи [1, 22].

3.2. Зміна параметрів оптимізації матеріалів

Перехід «кристал \rightarrow HC» зменшує величини T_{max} , n^{onm} (p^{onm}), а в багатьох випадках і E_F зразків (рис. 4). Це викликає необхідність зміни правил оптимізації HC TEM порівняно із кристалами. На рис.7 наведено діаграми Берхгольца, що якісно пояснюють відмінності в оптимальній концентрації носіїв струму в кристалах і HC [3]. З рис. 7 видно, що за умови α (крист)~ α (HC)~const (табл.1) оптимальна концентрація носіїв струму n_{onr} HC буде зменшуватись, причому відома неузгодженість між n_{onr} для Z i W збільшиться ($\Delta_1 > \Delta_2$).



Рис. 7. Діаграми Берхгольца ТЕМ. 1, 2, 4, 5, 7, 9 – кристали; 1, 3, 6, 10, 11, 12 - HC (T= 300 K). Характеристики: 1- $\alpha \sim \alpha(\kappa pucm) \sim \alpha$ (HC) $\sim const; 2, 3 - \sigma; 4, 11 - \kappa = \kappa_L + \kappa_e; 5, 12 - \kappa_L; 6, 7 - Z; 9, 10 - W$. Розузгодження по n_{onm} між Z i W : Δ_1 - HC; Δ_2 – кристали. 8 – перехід λ_{ph} - а..

Неузгодженість $\Delta_1 > \Delta_2$ може призвести до необхідності розробки НС ТЕМ з різними параметрами стосовно режимів максимального ККД і максимальної потужності ТЕП.

3.3. Контактні ефекти й економія матеріалів

Перехід «кристал \rightarrow HC» супроводжується ростом теплового ($rt = \kappa^{-1}$) і електричного опору ($\rho = \sigma^{-1}$) зразків. У результаті використання HC TEM у ТЕП супроводжується ростом перехідних контактних теплових і електричних опорів термопар, що може призводити до необхідності збільшення довжини віток і зниження ККД приладів [1, 6]. Однак в [23] було показано, що для випадку автомобільних термоелектричних генераторів (АТЕГ), що використовують газоподібні теплоносії [6], внесок контактних опорів HC ТЕМ може бути несуттєвим порівняно з паразитними опорами теплообмінників. У цьому випадку використання HC ТЕМ може призводити до одночасного підвищення ККД ТЕП і істотної економії дорогих ТЕМ (до 3 разів і більше) [24]. Однак

у випадку ТЕП, що використовують рідкі та тверді теплоносії, внесок контактних опорів НС у ККД ТЕП може виявитися істотним, і це слід враховувати при розробці приладів [6].

Висновок

Дослідження НС ТЕМ – новий, перспективний напрямок сучасного матеріалознавства [1, 2]. У пропонованій роботі проведений всебічний аналіз характеристик НС ТЕМ і визначено механізми підвищення їх термоелектричної добротності Z і потужності W. Показано, що в основі росту параметра Z HC лежить перехід TEM у фазу «фононне скло – електронний кристал» (ФСЕК). Можливість утворення фази ФСЕК у зразках ($a = \lambda ph < \lambda e$) пов'язана в роботі із близькістю ТЕМ до переходів $\lambda_{ph} \rightarrow a$ і $\lambda_e \rightarrow a$ (тут a – міжатомна відстань, λ_{ph} і λ_e – середня довжина вільного пробігу фононів і електронів). Для визначення ступеня близькості до фази ФСЕК у роботі розвинений метод λ – діагностики ТЕМ, заснований на оцінці величин λ_{ph} і λ_e у зразках [16]. Застосування λ діагностики дало можливість встановити, що ріст Z і W HC TEM, а також кристалів TEM за високої температури визначаються одними й тими ж механізмами. Цей результат дав можливість оцінити теоретичні межі підвищення параметрів Z і W HC TEM у різних інтервалах температур. Оцінки показали, що найбільший ріст Z HC ТЕМ можливий за кімнатної і нижчих температурах, з ростом температури можливості росту Z HC ТЕМ знижуються. Застосування λ – діагностики дало можливість визначити також механізми, відповідальні за ріст Z і W HC TEM. Показано, що утворення фази ФСЕК і ріст Z HC ТЕМ відбувається за рахунок зменшення κ_{L} , λ_{ph} з переходом $\lambda_{ph} \rightarrow$ *а*. При цьому супутній перехід $\lambda_e \rightarrow$ а здебільшого знижує *W* ТЕМ через зменшення $\sigma \sim \lambda_e$. Оскільки зниження W утруднює використання HC TEM у силових ТЕП, потрібне додаткове збільшення α і W НС ТЕМ різними методами. У даній роботі для цього запропоновано використовувати ефект двоканальної провідності, що забезпечує одночасний ріст Z i W в інтервалі $1 \sim \lambda_{ph}/a < \lambda_e/a < 2$ - 3. У роботі розглянуто також деякі негативні характеристики НС ТЕМ, що перешкоджають їхньому широкому використанню в ТЕП. Зокрема визначені інтервали дифузійної нестійкості НС за високих температур. Показано, що нині «безпечний» інтервал використання «штучних» НС ТЕМ, очевидно, обмежується температурами, близькими до кімнатної й нижчими. Можна думати, що зазначені недоліки НС ТЕМ можуть бути переборені, а стійкість зразків за високих температур збільшена за допомогою різних технічних методів. Однак, оскільки в наш час зазначені проблеми не вирішені, найбільш перспективними для використання за високих температур поки представляються тільки «природні» НС типу природних надграток на основі багатокомпонентних систем.³ Також великий інтерес являють собою «природні» нано - подібні структури типу GeTe, TAGS і LAST на основі сильно розупорядкованих фаз, що вже довели свою надійність безперебійною роботою на космічних об'єктах упродовж 10 років і більше [1, 6, 10].

Література

- 1. Nolas G.S., Sharp J., Goldsmid H.J. Thermoelectrics. Basic Principles and New Materials Developments. Berlin: Springer. 2001. 293 p.
- Slack G. New materials and performance limits for thermoelectric cooling // CRC Handbook of Thermoelectrics. Ed.: Rowe D.M. – N.Y.: Boca Raton. 1995. – P. 407 – 440.

³ До «природних» НС належать також шаруваті кристали типу Bi_2Te_3 , період ідентичності яких $x \sim 3$ нм виявляється дещо меншим від оптимального для ТЕМ ($x \sim 10 - 40$ нм) [1, 2].

- Биркхольц У. Термоэлектрические элементы / У Биркхольц // В сб: Аморфные и поликристаллические полупроводники. Под ред. В. Хейванга. Пер. с нем. – М.: Мир. 1987. С.47–74
- 4. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. / Л.И. Анатичук // К.:Наук. думка, 1978. 768 с.
- Механизмы увеличения термоэлектрической эффективности в объемных нано структурных поликристаллах / Л.П. Булат, Д.А. Пшенай-Северин, И.А. Драбкин [и др.] // Термоэлектричество. – 2011. – № 1. – С. 14 – 19.
- 6. Охотин А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Охотин, А.А. Ефремов, В.С. Охотин, А.С. Пушкарский // М.: Атомиздат. 1976. 320 с.
- 7. Harman T.C., Taylor P.J., Walsh M.P., LaForge B.E. Quantum Dot Superlattice Thermoelectric Materials and Devices // Science. 2002. V. 297. P. 2229.
- Ventkatasubramanian R., Siivola E., Colpitts T., O'Quinn B. Thin-film thermoelectric devices with high room-temperature figures of merit // Nature. 2001. – V. 413 (6856). – P. 597 – 602.
- Материалы на основе твердого раствора *Bi*_{0.5}*Sb*_{1.5}*Te*₃, полученные с использованием метода спинингования / Л.Д. Иванова, Л.И. Петрова, Ю.В. Гранаткина [и др.] // Термоэлектрики и их применения. Под ред. М.В. Ведерникова, Л.Н. Лукьяновой. – СПб: ПИЯФ РАН.– 2010. – С. 88 – 93.
- Sootsman J., Chung D.Y., Kanatzidis M.G. New and Old Concept in Thermoelectric Materials // Angew. Chem. Int. Ed. – 2009. – V. 48. – P. 8616 – 8639.
- Восканян А.А. Влияние характера теплового поля на электрические свойства селенида меди / А.А. Восканян, П.Н. Инглизян, Я.М. Шевченко, Т.Б. Шмакова // ФТП. 1980.–Т.14.–№4.–С.80 – 806.
- Коржуев М.А. Электрофизические свойства суперионного *Си*_{2-х}*Se* / М.А. Коржев, В.Ф. Банкина, Б.Ф. Грузинов, Г.С. Бушмарина // ФТП. 1989. Т.23. №9. С.1545-1551.
- 13. Коржуев М.А., Банкина В.Ф., Ефимова Б.А., Филипович Н.Н. Электрофизические свойства сплавов *Си*_{2-х}*Se*, легированных электроактивными добавками // ФТП. 1990. Т.24.–№5.–С.805–812.
- Термоэлектрические материалы на основе слоистых соединений в халькогенидных системах с гомологическими рядами / В.С. Земсков, Л.Е. Шелимова, О.Г. Карпинский, [и др.] // Термоэлектричество. 2010. – №5. – С.18 – 33.
- 15. Коржуев М.А. Использование двуканальной модели проводимости для описания кинетических коэффициентов кристаллов типа Ge_{1-x}Te и Cu_{2-x}Se в области высоких температур / М.А. Коржуев, А.В. Лаптев, В.Ф. Дегтярев // Термоэлектрики и их применения. СПб.: НИЯФ. 2002. С.133 138.
- 16. Коржуев М.А. Влияние средней длины свободного пробега фононов и электронов на параметры добротности Z и мощности W термоэлектрических нано- структур / М.А. Коржуев // Термоэлектрики и их применения. Под ред. М.И. Федорова, Л.Н.Лукьяновой. – СПб.: ПИЯФ. 2012. – С.99 – 105.
- 17. Коржуев М.А. Сопутствующие эффекты в высокоэффективных термоэлектрических материалах / М.А. Коржуев // Высокочистые вещества. 1996. №2. С.74- 89.
- Korzhuev M.A. Symmetry Analysis of Thermoelectric Energy Converters with Inhomogeneous Legs // JEMS. 2010. – V.39.- №9. – P.1381 – 1385.
- 19. Коржуев М.А. Эффект Холла в термоэлектрических материалах типа *Ge*_{1-x}*Te* и *Cu*_{2-x}*Se* в области λ → *a* / М.А. Коржуев // ФТТ. 1993. Т.35. №11. С.3043 3052.
- Физико- химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. Под ред. Новоселовой А.В. – М.: Наука, 1979. – 340 с.

- 21. Киселева Н.Н. Запрещенная зона твердых тел (полупроводники, диэлектрики, полуметаллы). Определение запрещенной зоны неорганических веществ- полупроводников / Н.Н. Киселева, В.А. Дударев, М.А. Коржуев // Datebase «Bandgap» b.g.imet-db.ru/ about database.asp. 2007.
- 22. Кадзикава Т. Успехи в области термоэлектрической технологии генерирования электроэнергии в Японии / Т. Кадзикава // Термоэлектричество. 2011. №3. С.5 19.
- 23. Мейер К. Физико- химическая кристаллография. / К. Майер // Пер. с нем. М.: Металлургия, 1972. С. 480
- 24. Коржуев М.А. Некоторые «узкие места» автомобильных термоэлектрических генераторов и поиск новых материалов для их устранения / М.А. Коржуев, Ю.В. Гранаткина // Термоэлектричество. 2012. №1. С.81 94.

Надійшла до редакції 22.04.2013